

2025 年 6 月期第 3 四半期 WEB 決算説明会（2025 年 5 月 13 日開催）**およびアナリストミーティングの主な質疑応答****【新中長期経営計画】****1. なぜ今回は、現中期経営計画を廃止して、新中長期経営計画を策定することに至ったのか？**

A: 過去数年間、既存の経営資源を活用し、半導体・パワーデバイス・バッテリーなど 5 つの成長ドライバーを定めて事業の成長に取り組んできた。しかし、パワーデバイスやバッテリー分野においては、外部環境の急激な変化などの影響により成長が継続せず、来期を最終年度とする現中期経営計画の目標達成が困難であることが明らかになった。

将来的に半導体・電子分野を中心としたさらなる成長を実現するためには、現行計画の延長線上では成長に限界があり、抜本的な改革が必要であると判断した。そのため、現行計画を廃止し、早期に新中長期経営計画「バリューアッププラン」をスタートさせることを決定した。

2. 新中長期経営計画は、これまでの中期経営計画と何が違うのか？6 年間という長期スパンにしたのは何故か？

A: 新中長期経営計画では「事業改革」「生産改革」「成長戦略」の 3 つを柱とし、半導体電子中心の事業ポートフォリオへの見直しを加速させ、高成長・高収益性を実現することを目指す。

特に「事業改革」においては、これまでの中期経営計画とは異なり、低採算事業の縮小や撤退を含む施策を実施することで、経営資源の最適化を 2 年間で完遂させる点が大きな違いである。

6 年間という長期スパンを設定した理由は、最初の 2 年間で経営基盤を強化する「事業改革」を完遂し、その後の 4 年間で成長効果を最大化するためである。この 2 段階のアプローチにより、持続的な成長を確実に実現する。また、31 年 6 月期には営業利益率 22% を目標としており、成長効果が本格的に現れ始めるのは 3 年目以降と見込んでいることから、3 年間では効果を最大化することが難しいと判断し、6 年間という長期スパンを設定した。

【25/6 期 業績予想】**3. どのような要因で通期業績予想の下方修正に至ったのか？なぜ、2Q 時点で下方修正しなかったのか？**

A: 通期受注高の前回予想からの減少は、総じて EV 関連ビジネスの停滞が主な理由である。具体的には、半導体・電子分野では前回予想比▲80 億円の減少が見込まれており、その主因はパワーデバイスの受注減少で、日本・中国ともに低調に推移したことが影響している。また、ディスプレイ・エネルギー分野では前回予想比▲145 億円の減少が見込まれており、これは主にバッテリー関連ビジネスの受注低迷によるもの。さらに、コンポーネント分野では前回予想比▲40 億円、一般産業分野では前回予想比▲45 億円の減少が見込まれているが、これらの減少も、EV 関連ビジネス投資の低調が主な原因となっている。

3Q で見込んでいた受注高が 4Q や来期へ期ずれしたことにより、今期計上を予定していた売上高や各利益項目についても来期へ期ずれしたため、通期業績予想の下方修正に至った。

2Q 時点では、パワーデバイスやバッテリーなどの下期受注がある程度落ち込むことを予測していたため、一部受注高を見直した。しかし、これほどまでに急激な悪化を想定していなかったため、2Q 時点では通期業績予想を据え置いていた。

4. 4Q以降、来期はどのように見ているのか？

A: 4Q および来期については、半導体・電子分野の需要回復を見込み、成長基調に戻る計画。これにより、受注・売上ともに回復が期待される。一方で、来期には低採算事業の縮小や撤退を進める方針のため、多少売上が減少する可能性があるものの、利益面においては、収益性の高い半導体・電子関連の売上構成比が増加することや、生産改革の効果が一部反映されることを踏まえ、売上総利益率の増加を想定している。来期予想は8月開示で改めて示す。

【売上高・利益（率）】

5. 3Q売上高が2Q比で減少したにも関わらず、売上総利益率2Q：32.2%→2Q:33.3%と1.1pt改善した理由は？

A: 3Q 売上総利益率が33.3%と改善した主な理由

- 1) ディスプレイ・エネルギー関連製造装置の売上高が減少したことによるミックス改善
- 2) 表面分析装置の売上高が利益率の高い地域に集中したこと、などによる

通期の売上総利益率は32%を見込んでおり、利益率が相対的に高い半導体電子の売上高構成比は高まっていることもあり、利益率のベースは着実に改善している。

6. 3Q累計の半導体電子およびディスプレイ・エネルギーの受注高・売上高の用途別内訳は？ また、3Q累計の営業利益率順位は？

A: 別紙のとおり。

【市場環境・投資動向】

7. 生成AI関連ビジネスとして、ロジック・メモリの半導体・パッケージングビジネスはどのような見通しなのか？

A: ロジック

DUV 露光装置向けMHM（Metal Hard Mask）の適用拡大が進んでおり、3Q～4Qにかけて受注が増加している。そして、4Qには先端ロジック向けの受注も期待している。今後、2nm世代への進展に伴い、トランジスタがFin構造からSheet構造へ移行する中、既にPOR（Process of Record）を獲得している拡散工程のための新しいハードマスクの受注拡大が期待されている。また、ハードマスク用途の増加に加え、セカンドベンダーとしての期待もあり、他の金属工程等の共同開発が進行中であり、さらなるPOR獲得件数の拡大を目指している。

メモリ

DRAM: 生成AI関連のDRAM（DDR5）、HBM投資の一部が来期に期ズレする見込みであるも、来期以降は投資拡大が期待されている。

NAND: 次世代NAND向け投資が継続しており、安定した需要が見込まれる。

引き続き、DRAM・NANDにおいて、他の金属工程等の共同開発が進行中であり、さらなるPOR獲得件数の拡大を目指している。

パッケージング

インターポーザ向けアッシング（デスクラム）装置が好調で、通期受注は130億円を超える見込みである。次世代先端パッケージング向けスパッタリング装置、デスクラム・デスクリア処理装置、プラズマダイシング等の開発も進んでおり、積極的に取り組みビジネス拡大を目指す。

8. EV 需要鈍化等による影響として、パワーデバイス・バッテリー・一般産業の投資トレンドはどのようになるのか？

A: パワーデバイス

中国市場では足もとで投資回復の兆しも見え、8 インチ化への投資が進む見込みだが、日本市場では EV 市場の成長鈍化により投資再開まで約 1 年を要する見通しであり、本格的な投資は 2027 年 6 月期以降に進められると予想している。中長期的に SiC パワーデバイス需要は増加すると見込まれており、デバイス構造がプレナーからトレンチ構造に移行することで、SiC 化合物に適したエッチング装置の拡販も目指す。また、GaN 化合物のスパッタリング装置を市場に投入しており、将来の需要を取り込んでいきたい。

バッテリー

バッテリーメーカーによるアルミ両面蒸着膜の試用が増加しているが、量産投資は依然として鈍化している。今後、車載用途の進展に伴い投資が本格化すると見込まれる。また、アルミ両面蒸着膜のフィルム幅を広げ生産性をさらに向上させることで差別化を図り、市場シェアを確保していく方針である。さらに、銅両面蒸着膜やリチウム膜などで中長期的な成長を目指す。

一般産業

EV モーターに搭載される高機能磁石製造装置について、各磁石メーカーが収益改善を図るため、大型投資を控える傾向にある。一方で、中国リスクを背景に、中国以外の地域での投資案件が増加している動きがあり、これらの案件に積極的に取り組むことで成長を図っていく。

9. 主な機種別のリードタイムを教えてください。

A: 顧客への納期リードタイムという点では、

ロジック・メモリ向けスパッタ装置は、計画的生産対応機種は 3～5 ヶ月、

(フォーキャストの無い新規案件は装置仕様によって幅があるが、平均 8 か月)

電子デバイス関連で、標準仕様のスパッタ、蒸着、エッチング装置は 5～9 か月、

特型装置は受注してから部品発注を行うため 10 ヶ月以上となるものもある。

パワーデバイス用イオン注入装置は標準仕様で 7 ヶ月程度、特型装置は 10 ヶ月以上をこえるものもある。

バッテリー向け両面蒸着巻取装置は、10～11 ヶ月程度となっている。

10. 米国による中国半導体輸出規制等の影響は？

A: 現状、MHM の DUV 露光への適用拡大等に伴い、引き合いは徐々に増加している。仮に米国による規制が強化されたとしても、中国における半導体関連ビジネスのウェイトはそれほど大きくないが、影響は限定的と見ている。一方で、パワーデバイスや各種電子デバイス、バッテリーなどに対する規制強化は認識しておらず、現時点ではビジネスへの影響を感じていない。

11. 関税の影響は？

A: 基本的に関税については、買い手負担を適用しているため、関税による直接影響は限定的である。エンド需要減速による間接影響を見定めていくことになる。現時点で顧客からの受注に目立った変化はない。なお、関税政策が固まっていない不透明な状況であることから、通期業績予想には関税影響は織り込んでいない。7 月以降の動向を注視していく。

以上

別紙：品目別内訳割合・営業利益率順位

●受注高 品目別の内訳割合

受注高	25/6期 3Q累計
半導体電子（億円）	518
・メモリ	3割強
・ロジック	2割強
・電子部品	2割弱
・パワー半導体	1割強
・パッケージング	2割弱
・その他	-
ディスプレイ・エネルギー（億円）	326
・LCD	3割強
・OLED	6割強
・バッテリー	数%
・その他	一桁台半ば

●売上高 品目別の内訳割合

売上高	25/6期 3Q累計
半導体電子（億円）	673
・メモリ	2割強
・ロジック	2割弱
・電子部品	約2割
・パワー半導体	2割半ば
・パッケージング	1割強
・その他	-
ディスプレイ・エネルギー（億円）	411
・LCD	3割強
・OLED	4割強
・バッテリー	約2割
・その他	一桁台半ば

●営業利益率順位 25/6期 3Q累計

順位	品目
1	コンポーネント
2	半導体電子
3	一般産業
4	その他
5	マテリアル
6	ディスプレイ・エネルギー

全社平均利益率は
 3) 一般産業と
 4) その他との間